

導入年度	H29年	設備名	マイクロフォーカス X 線 透過・CT検査装置		
メーカー	株島津製作所	型式	inspeXio SMX-225CT FPD HR	設置室	システム技術試験室

H28年度 地域新成長産業創出促進事業(地域未来投資の活性化のための基板強化事業)

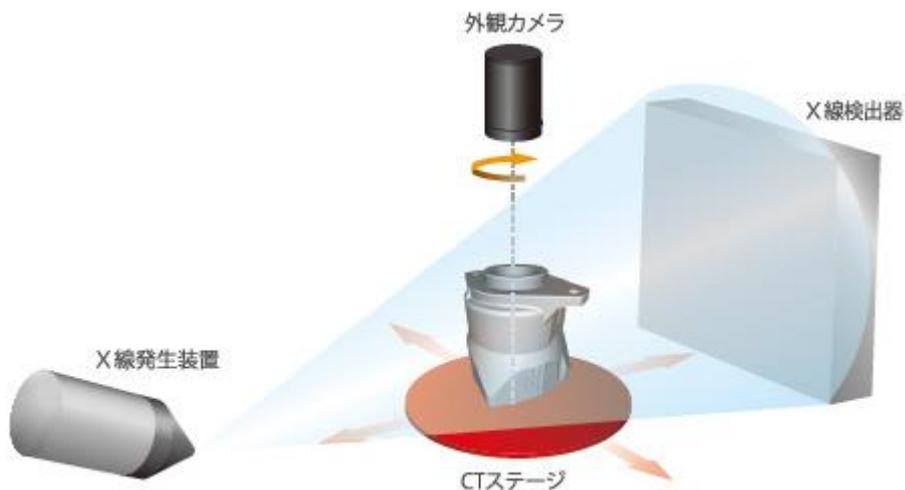
《 概要 》

・電子部品やプリント基板等の製品に対して、微小焦点型のマイクロフォーカス X 線を照射し、高分解能の透視画像、CT 画像を出力することで、内部の非破壊検査が行えます。また、多数のCT画像を収集することで3次元立体画像を構成し、製品内部構造の3次元解析が可能です。

《 装置外観 》



《 装置外観 》



《仕様》

- ・画像分解能：4 μ m
- ・最大管電圧：225kV
- ・CT撮影最大視野： ϕ 400mm程度
- ・検出器：X線フラットパネル検出器(400mm \times 400mm)
- ・搭載可能な試料の最大寸法： ϕ 400mm \times H300mm（試料固定用治具を含む）
- ・搭載可能な試料の最大重量：12kg（試料固定用治具を含む）
- ・CT走査モード：ノーマル走査、ハーフ走査、オフセット走査、FanShaped走査
- ・CT撮影断面画像サイズ：512 \times 512, 1024 \times 1024, 2048 \times 2048

《用途》

- ・小型電子機器や多層プリント基板の内部構造の3次元画像解析
- ・部品実装基板のBGA（ボールグリッドアレイ）等はんだ接合部の不具合解析、ボイド（気泡）の検出、計測評価
- ・モールドされた電子部品内部のクラック等、微小な欠陥の検出
- ・ハイブリッドICのボンディングワイヤの断線検査、3次元位置関係の把握
- ・各種小型部品、アルミダイカスト品の内部構造の検査、解析

《画像撮影例》

